Mediálním partnerem konference je odborný časopis DPS ELEKTRONIKA od A do Z

ZAŘAZENÍ DO DATABANKY SMT-INFO 2027 a plánované akce na rok 2027:

SMTinfo 10/27 – 12.–13. října 2027 **ano-ne**

Pájení a tepelné procesy, opravy v SMT, čištění DPS, trendy v mikroelektronice, defekty pájených spojů

Jméno a příjmení, titul .....

.....

e-mail .....

Název a adresa podniku (PSČ) .....

.....

Telefon .....

AKTUALIZACE A ZAŘAZENÍ do dB SMTinfo zasílejte prosím e-mailem na adresu info@smtinfo.cz, www.smtinfo.cz

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

MÍSTO KONÁNÍ:

Střední škola informatiky, Čichnova 23, 624 00 Brno

SPOJENÍ DO MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE:

- z hlavního nádraží ČD tramvaj č. 1, směr Bystrc, výstup zastávka **vozovna Komín** (cca 20 min. jízdy)
- z autobusového nádraží přejít pěšky k nádraží ČD (cca 7 min.) a odtud pokračovat tramvají č. 1, směr Bystrc, výstup **vozovna Komín**
- vlastní dopravou – od brněnského výstaviště směr Bystrc (přehrada), před prodejnou OPEL (po levé straně silnice) odbočit doleva na Jundrov, za prodejnou OPEL směr vpravo, odtud se již po pravé straně nachází areál SŠ informatiky s možností parkování.

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY:

Zašlete e-mailem, ev. poštou spolu se závazným požadavkem na stravu nejpozději do **11. 10. 2026** na adresu: **e-mailem: info@smtinfo.cz,** ev. **smtinfocz@gmail.com**

AKTUALIZACE A ZAŘAZENÍ do dB SMTinfo zasílejte prosím e-mailem na adresu info@smtinfo.cz

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

Ubytování **nezajišťujeme.**
Každý si zajistí ubytování dle vlastního požadavku na níže uvedené kontaktní adrese:

Ubytování na Střední škole informatiky Čichnova 23, Brno-Komín

Telefonické objednávky: **00420-541 123 364**
p. Podborská, p. Pantůčková

Ubytování je zajišťováno v buňkách hotelového typu

STRAVOVÁNÍ: oběd v areálu SŠ informatiky á 140,- Kč

PREZENCE: 13. 10. 2026 8.00 – 8.30 hod.

Účastnický poplatek včetně občerstvení a bulletinu
(úhrada při prezenci)

13. 10. 2026 **850,- Kč**

SMT-INFO KONSORCIUM

ve spolupráci s

FEKT VUT v Brně
a
SŠ INFORMATIKY BRNO

Vás zvou
na mezinárodní konferenci

BRNO SMT – info 10/26

PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY
ČIŠTĚNÍ DPS
NOVINKY V MIKROELEKTRONICE
VADY PÁJENÉHO SPOJE

BRNO 13. října 2026
SŠ informatiky
Čichnova 23, Brno-Komín

kód akce 10/26

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE:

- PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY
- ČIŠTĚNÍ DPS
- NOVINKY V MIKROELEKTRONICE
- VADY PÁJENÉHO SPOJE

ODBORNÁ NABÍDKA:

- Účastníci konference vyslechnou nejnovější informace z výše uvedených tematických oblastí od odborníků renomovaných firem
- V přilehlých prostorách přednáškového sálu budou instalovány stánky následujících firem s odbornou literaturou a demonstračními zařízeními:

ADOPT SMT **AIM SOLDER EUROPE**
AMTEST GROUP **JAMI ELECTRONICS**
PAN ELECTRONICS

Pro účastníky a návštěvníky konference budou k dispozici reklamní tabule pro propagaci vlastních výrobků a nabídku nevyužívaných technologických zařízení a služeb.

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ DALŠÍCH AKCÍ POŘÁDANÝCH SMT-INFO:

SMT-INFO 10/2027 **12. – 13. října 2027**

Místo konání: SŠ informatiky, Čichnova 23, Brno

- PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY
- ČIŠTĚNÍ DPS
- NOVINKY V MIKROELEKTRONICE
- VADY PÁJENÉHO SPOJE

ODBORNÝ GARANT:

SMT-INFO KONSORCIUM
tel.: 00420-541 146 113
mobil: 00420-602 542 966
e-mail : info@smtinfo.cz, smtinfocz@gmail.com

PROGRAM KONFERENCE

Úterý – 13. října 2026

8.45 - Zahájení, úvod

8.50 - Metoda smáčecích vah - hodnocení smáčitelnosti povrchu roztavenou pájkou /K. Dušek, ČVUT FEL Praha/

9.10 - Nové materiály pro selektivní lakovaní a výrobu elektroniky /B. Gyorffy, HUMISEAL / Chase Corporation, J. Vondráček, AMTEST GROUP/

9.40 - Vývoj bezolovnaté pájecí pasty s nízkou tvorbou dutin pro aplikace vyžadující vysokou spolehlivost /S. Abdourahime, INVENTEC, JAMI ELECTRONICS Praha/

10.00 - Občerstvení, káva

10.20 - Technologie CLAD: Digitální laserové nanášení materiálů v SMT výrobě /S. Etienne, ioTECH, A. Kollár, AMTEST GROUP/

11.05 - FUJI SMART FACTORY – Budoucnost chytré výroby /R. Kolka, AMTECH Brno/

11.30 - Využití A.I. ve strojích Koh Young /M. Drlík, IMT Technologies and Solutions Val. Meziříčí/

11.50 - Diskuse

12.00 - Nové trendy – pájení bez tavidel /M. Hurban, REHM Česká republika Příbor/

12.20 - Nový přístup k čištění elektronických sestav /V. Sítko, PBT WORKS Rožnov pod Radhoštěm/

13.00 - Oběd

13.40 - Malé procesy, velký dopad: Chytré podpůrné technologie v SMT výrobě /L. Pokorný, AMTEST GROUP/

14.00 - Vliv typu slitiny na výsledky/spolehlivost AOI /A.Sedlák, AIM SOLDER/

14.20 - Inspekční systémy Magic Ray /M. Javůrková, NETA SMT Brno/

14.40 - Jednotná terminologie napříč elektrotechnickými obory /J. Křivka, ČESKÁ AGENTURA PRO STANDARDIZACI Praha/

14.55 - Vliv návrhu thermal relief na zaplnění PTH otvorů při pájení vlnou /J. Dokoupil, FEKT VUT Brno, RESIDEO Brno/

15.10 - Diskuse, závěr konference

Přednášky budou prezentovány v češtině nebo v angličtině. Změny programu vyhrazeny.